



TECHNICAL DATA SHEET

(BK-A2000)

2024.12.10

Rev. 0

1/2

주식회사 보광

- ▣ 제품명 : BK-A2000
- ▣ 제품 유형 : 용제형 아크릴 접착제(이액형)
- ▣ 외관 : 무색 투명

- ▣ 제품 물성
 - 고형분 : 26±1%
 - 점도 : 2,000~2,400 cps(30°C) / Brookfield viscometer(DV2T)

- ▣ 사용 방법
 - 건조 : 60°C x 3분 (또는 120°C x 3분)
 - 숙성 : 30°C x 16시간

☞ 제품을 사용하기 전에 접착제/경화제를 100/0.85 비율로 잘 섞은 후 사용하세요.

▣ CREEP TEST (Overlap area: 25mm² / 1kg x 1 hour dwell time to stainless steel)

Stainless steel(SUS 304)	5 μ m	10 μ m	20 μ m	50 μ m
Creep test-1	220°C(전사 50%)	220°C(전사 50%)	220°C(전사 50%)	220°C(전사 50%)
Creep test-2	160°C	160°C	160°C	160°C

- ☞ Note : Creep test-1 (전사와 관계없이 1시간 동안 유지한 온도), (%) 전사된 정도
- : Creep test-2 (1시간 동안 유지한 온도에서 전사가 없음)
- : Creep 시험(1kg 주 사용)후의 시편이 아래로 밀리는 현상이 전혀 없음

▣ 피착제 별 내열성 시험

피착제	시험 온도	1kg 하중(180°)	0.5kg 하중(180°)	0kg 하중
PET film	200°C	5분 유지	5분 유지	15분 유지
		전사 0% (Tack 유지)	전사 0% (Tack 유지)	전사 0% (Tack 유지)
	220°C	5분 유지	5분 유지	5분 유지
		전사 0% (Tack 유지)	전사 0% (Tack 유지)	전사 0% (Tack 유지)
PI film	280°C	15분 이하	-	5분 유지
		전사 60% (Tack 유지)	-	전사 0% (Tack 유지)

- ☞ Note : 도포 두께(20 μ m)

▣ 피착제 별 접착력(180° Peel adhesion, 300mm/min at R.T); UTM(500N)/ZwickRoell

Substrates	도포 두께 (5 μ m ~ 50 μ m)
SUS	0.80 ~ 1.80 kgf/in
Glass	0.70 ~ 1.60 kgf/in
PVC	0.70 ~ 2.00 kgf/in ***
PC	0.80 ~ 1.70 kgf/in
ABS	0.70 ~ 1.60 kgf/in **

- ☞ Note : ** (피착제 전사 20~50%)
- *** (피착제 전사 50% 이상)

▣ 경시점도 변화 / Brookfield viscometer(26% solids / 30°C)

초기	1시간 후	2시간 후	4시간 후	7시간 후
2,200 cps	3,200 cps	2,800 cps	2,800 cps	2,700 cps

울산광역시 남구 여천로 217번길 3(여천동), (주) 보광 울산공장 기술부

Tel : 052-272-5461(240)



주식회사 보광

TECHNICAL DATA SHEET

(BK-A2000)

2024.12.03

Rev. 0

2/2

■ 건조 조건에 따른 숙성시간 별 접착력의 변화(180° Peel adhesion, 300mm/min at R.T);
UTM(500N) ZwickRoell

건조 조건	숙성시간 (30°C at Drying oven)			
	18시간	42시간	90시간	138시간
60°C x 3분	1.50 kgf/in	1.50 kgf/in	1.50 kgf/in	1.70 kgf/in
120°C x 3분	1.50 kgf/in	1.50 kgf/in	1.60 kgf/in	1.70 kgf/in

☞ Note : 도포 두께(20μm)

건조 후, 테이프를 SUS판에 부착하여 숙성시간 별 접착력 시험

■ 특징

- 우수한 내열성(약 200°C 이상 creep 1시간 유지 / 최고 280°C creep 15분 유지)
- 안정한 경시점도에 의한 균일한 품질의 제품화 및 작업성 향상
- 황변이 없으며 장기간에 걸쳐 안정된 접착성능과 뛰어난 재박리성(전사 없음)
- 다양한 피착재에 대한 우수한 접착성능

■ 용도

- Flexible Printed Circuit Board (FPCB) 및 무연 solder reflow 공정(반도체 및 PCB)
- 고내열 마스크 및 고내열 전기 절연용 접착 테이프(통상 사용온도 범위 150°C)
- 알루미늄 테이프(보일러 보수용 등)

■ 메모